

江苏芯丰集成电路封装压焊图

图号:314BD015

版本 A.0

贴片方向 (芯片与片环方向示意图)

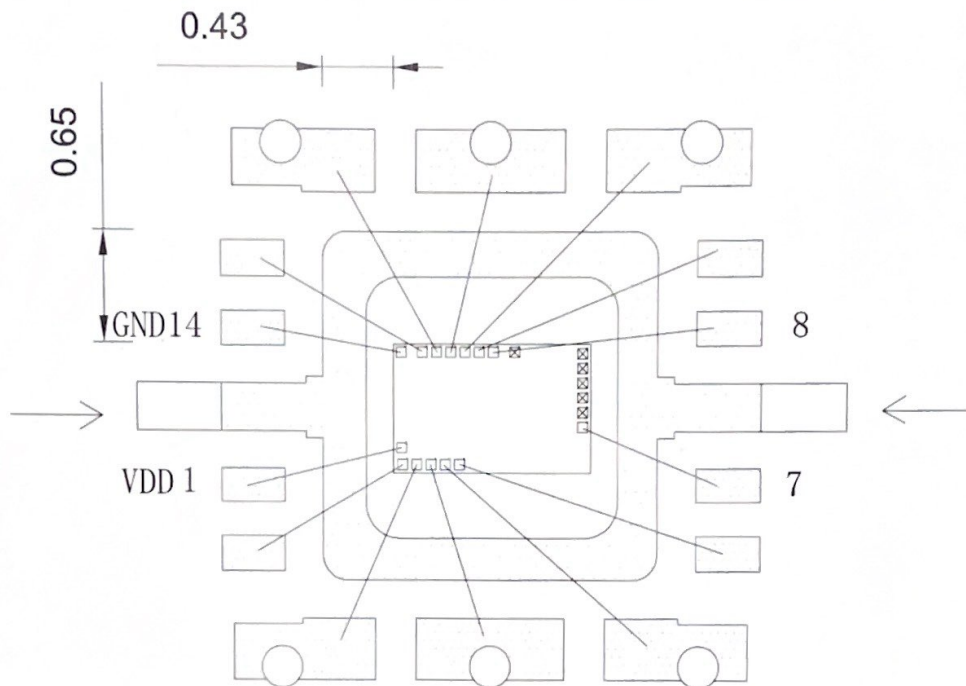


框架传输进料方向

第一个孔为椭圆孔



备注及特殊要求 (Remark&Special Instruction)

框架到芯片最高点的线弧高度<550um
居中装片请仔细核对焊线位置, 以及材料选择。 如无误
请签字回传, 谢谢!

客户回签: 穆保国 2024.04.22

顶针		点胶方式		如选择UV膜 请确认 产品是否可以照 射紫外线, 如不能请讲明	<input type="checkbox"/> UV膜 <input checked="" type="checkbox"/> 蓝膜	风险监控: 低风险		
单顶针	多顶针	点胶	画胶					
	/		/					
产品型号 (Product Type)	HS26P10			线材直径 (Wire Diameter)	银合金线0.8mil	芯片减薄厚度 Chip thinning thickness	300±10um	
芯片名称 (Die Name)	HS5085			压焊点尺寸 (Pad Opening)	60X60um	装片胶 Epoxy (二选一)	首选	9246LB5(导电胶)
芯片尺寸 (Die Size)	1.195X0.755mm			最小压焊间距 (Min Pitch)	86um		备选	/
封装形式 (Package Type)	SOP14(8.65X3.9X1.4 e=1.27)			先焊线 (Wire Bond Start)	PIN14	塑封料 Molding Compound (二选一)	首选	EMC-GR710F GN
引线框 (Lead Frame)	SOP14L(80X80)-12R			焊线总数 (Quantity of Wire)	14		备选	EMG-600-2-SP1
L/F电镀方式 (L/F Plating Type)	雾锡			最长线长/总线长 (Length of Wire)	1.67/17.029mm	CUP/BOAC	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	
晶圆尺寸/切割方式 (Wafer Size/Cutting Mode)	8寸/刀片开槽+刀片切割			顶层铝厚度 (Top aluminum thickness)	1.5um	RF 芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
吸嘴 (suction nozzle)	RT-020-020-FT			切割道(Cutting Way)	60um	LOW-K芯片	<input type="checkbox"/> YES <input checked="" type="checkbox"/> NO	
拟制 Prepared by	顾馨 2024.04.18			审核 Checked by		批准 Approved by		